五　直径三〇〇ミリメートルのシリコンウエハーの外周の除外領域を二ミリメートル以下としたウエハーの表面に対するスライス、研削及び研磨の技術のうち、長さ二六ミリメートル、幅八ミリメートルの長方形に分割されたいずれの領域における平坦度が二〇ナノメートル以下を達成するために必要な技術（プログラムを除く。）

４　［略］

５　外為令別表の七の項（五）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

一　削除

二～五　［略］

第二十条　［略］

第二十一条　外為令別表の九の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

一・二　［略］

二の二　第八条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもの（同条第十一号ロに該当するものを除く。）の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

三　第八条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもの（同条第十一号ロに該当するものを除く。）の使用に必要な技術（プログラムを除く。）

四～六　［略］

七　第八条第九号から第十一号イまで又は本項第九号のいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

七の二　第八条第十一号ロ又は本項第九号の二に該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム

八　［略］

八の二　第八条第九号から第十一号イまで又は本項第九号のいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム

八の三　第八条第十一号ロ又は本項第九号の二に該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム

九　プログラムであって、第八条第九号イ若しくはハからホまで、第十号又は第十一号イのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの（第八条第九号イ又はハからホまでに係るものにあっては、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、その機能が、操作、管理又は保守に関するものに限定されているものを除く。）

九の二　プログラムであって、第八条第十一号ロに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの（侵入プログラムを除く。）

十～十七　［略］

２　外為令別表の九の項（二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

一～十四　［略］

［新設］

４　［略］

５　外為令別表の七の項（五）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

一　導体、絶縁体又は半導体に対してマスクパターンを転写させるためのリソグラフィ工程、エッチング工程又は成膜工程を条件設定するための物理的シミュレーションプログラム

二～五　［略］

第二十条　［略］

第二十一条　外為令別表の九の項㈠の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

一・二　［略］

二の二　第八条第九号から第十二号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

三　第八条第九号から第十二号までのいずれかに該当するものの使用に必要な技術（プログラムを除く。）

四～六　［略］

七　第八条第九号から第十一号まで又は本項第九号のいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

［新設］

八　［略］

八の二　第八条第九号から第十一号まで又は次号のいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム

［新設］

九　プログラムであって、第八条第九号イ若しくはハからホまで、第十号又は第十一号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの（第八条第九号イ又はハからホまでに係るものにあっては、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、その機能が、操作、管理又は保守に関するものに限定されているものを除く。）

［新設］

十～十七　［略］

２　外為令別表の九の項（二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

一～十四　［略］